

2014年2月4日

各 位

会社名 パナソニック株式会社
代表者名 取締役社長 津賀 一宏
(コード番号 6752 東証・名証第一部)
問合せ先 財務・IRグループ
グループマネージャー 若林 勇人
(TEL. 06-6908-1121)

半導体事業に関する会社分割(簡易吸収分割) および海外工場に係る子会社株式の譲渡について

当社は、本日開催の取締役会において、2014年6月1日(予定)を効力発生日として、当社のセミコンダクター事業部の半導体等の開発・製造・販売に関する事業を、当社が3月中に設立予定の新会社に、会社分割によって承継させること(以下、「本吸収分割」)を決議しました。

併せて、同年6月1日(予定)を効力発生日として、当社が子会社を通じて保有している、シンガポール、インドネシアおよびマレーシアで半導体組立工程を営む工場に係る3社の子会社の株式について、その全てを、半導体組立専門メーカーであるUTACホールディングス社(以下、「UTAC社」)の100%子会社であるUTACマニュファクチャリングサービシーズ社(以下、「UMS社」)に譲渡(以下、「本株式譲渡」)するため、当社およびUMS社との間で株式譲渡契約書を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は100%子会社に当社の事業部門を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

I. 会社分割および株式譲渡の背景および目的

当社の半導体事業は、これまで、AV市場から車載・産業市場へのシフトや、当社の強みである低消費電力技術、画像処理技術、化合物技術を活かした商品ラインアップ、ソリューションの展開を図るなど、事業構造転換を含む様々な施策を推進してきました。また、昨年12月20日に公表のとおり、外販獲得による稼働拡大をねらい北陸拡散工場の合併会社化(2014年4月1日実施予定)を決定するなど、競争力強化に向けた取り組みを進めています。

これらに加え、商品開発・マーケティングを基軸とした事業一元化によるソリューション力の強化およびアセットライト化による事業リスクの低減を図り、半導体事業の競争力をさらに高めるため、当社は、以下の施策を実施することを決定しました。

まず、当社のセミコンダクター事業部の半導体等の開発・製造・販売に関する事業を、2014年6月1日(予定)を効力発生日として、当社が3月中に設立予定の新会社に、会社分割によって承継させます。新会社の名称は、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社(以下、「PSCS」)を予定しております。また、同日を効力発生日として、当該新会社に、当社の100%子会社である、パナソニック デバイスディスプレイセミコンダクター株式会社(以下、「PIDDSC」)およびパナソニック デバイスオプティカルセミコンダクター株式会社(以下、「PIDOSC」)を吸収合併させます(以下、「本吸収合併」)。

また、当社は、アセットライト化を進めるため、2014年6月1日(予定)を効力発生日として、シンガポール、インドネシアおよびマレーシアで半導体組立工程を営む工場に係る以下の3社の子会社株式をUTAC社の100%子会社であるUMS社に譲渡します。当社は、本株式譲渡後も当該3社を半導体組立の生産委託先として活用することにより、UTAC社のスケールメリットを活かし競争力の強化を図ってまいります。

- (1) パナソニック オートモティブアンドインダストリアルシステムズセミコンダクター
シンガポール(仮称)(以下、PAISSCSG ※)
- (2) パナソニック デバイス インドネシア (以下、PIDID)
- (3) パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター マレーシア (以下、「PIDSCMY」)

※PAISSCSGは、パナソニック アジアパシフィック株式会社の100%出資で設立する予定の新会社で、本株式譲渡に際し、事前に当社のシンガポール拠点における半導体組立に係る資産の事業譲渡を受けます。

上記施策を通じ、当社は、成長分野である車載・産業関連を中心に、お客様のご要望を満たす、より魅力ある商品の開発と提供に努め、今後も半導体事業をグローバルに展開していきます。

II. 会社分割の内容

1. 本吸収分割の要旨

(1) 会社分割の日程

2014年3月27日(予定)	分割契約書承認取締役会
2014年3月27日(予定)	分割契約書締結
2014年6月1日(予定)	分割の予定日(効力発生日)

(注)本吸収分割は、当社においては会社法第784条第3項に定める簡易吸収分割に該当し、PSCSにおいては会社法第796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、それぞれ吸収分割の承認に関する株主総会を開催しません。

(2) 分割の方式

当社を分割会社とし、PSCSを承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

PSCSは、当社が新設する100%子会社であり、PSCSは、本吸収分割に際して対価の交付を行いません。

(4) 会社分割に係る新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(5) 会社分割により減少する資本金

本吸収分割により減少すべき資本金などはありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

PSCSは、当社セミコンダクター事業部から半導体等の開発・製造・販売に関する事業を遂行する上で必要と判断される資産および契約上の地位ならびにこれらに付随する権利・義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

PSCSが、本吸収分割後に負担すべき債務については、その履行の確実性に問題はないものと判断しています。

2. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (2013年3月31日現在)	承継会社 (2014年3月10日予定)
(1)名称	パナソニック株式会社	パナソニック セミコンダクター ソリューションズ株式会社
(2)所在地	大阪府門真市大字門真 1006 番地	京都府長岡京市神足焼町 1 番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長 津賀 一宏	取締役社長 藤本 佳司(予定)
(4)事業内容	電気・電子機器等の製造・販売	半導体および関連部品の 開発、製造、販売
(5)資本金	258,740 百万円	400 百万円
(6)設立年月日	1935 年 12 月 15 日	2014 年 3 月 10 日(予定)
(7)発行済株式総数	2,453,053,497 株	8,000 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 4.70% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.46% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3.59% 日本生命保険相互会社 2.97% THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 2.38% (2013年9月30日現在)	パナソニック株式会社 100%

(10)分割会社の直前事業年度の財政状態および経営成績(連結)

決算期	2013 年 3 月期
純資産	1,304,273 百万円(連結)
総資産	5,397,812 百万円(連結)
1 株当たり株主資本	546 円 81 銭
売上高	7,303,045 百万円(連結)
営業利益	160,936 百万円(連結)
当社株主に帰属する 当期純利益	△754,250 百万円(連結)
1 株当たり当社株主に 帰属する当期純利益	△326 円 28 銭

(注) 1. 百万円未満の金額は四捨五入しています。

2. パナソニック株式会社連結ベースでの株主資本の金額は、米国会計基準に従い、表示しています。

3. 当社は、自己株式 141,424 千株を保有しています(2013年9月30日現在)。

3. 分割する事業部門の概要

- (1) 分割する部門の事業内容
半導体等の開発・製造・販売

- (2) 分割する事業部門の経営成績

(単位:億円)

	2013年3月期 部門実績(単体)(a)	2013年3月期 当社実績(単体)(b)	比率(a/b)
売上高	1,625	39,170	4%

(注) 1. 比率については、小数点以下は四捨五入しています。

2. 億円未満の金額は四捨五入しています。

- (3) 分割する資産、負債の項目および金額(2014年6月1日見込)

(単位:億円)

資 産		負 債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	663	流動負債	652
固定資産	344	固定負債	37
合 計	1,007	合 計	689

(注) 億円未満の金額は四捨五入しています。

4. 会社分割後の当社の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期いずれも本吸収分割による影響はありません。

5. PSCS に吸収合併させる当社 100%子会社2社の概要

- (1) PIDDSC の概要(2013年12月31日現在)

① 名称	パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター株式会社
② 所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 水越 成彦
④ 事業内容	汎用ディスクリート半導体、部品の製造・販売
⑤ 資本金	2,700百万円
⑥ 設立年月日	2005年10月1日
⑦ 決算期末	3月31日
⑧ 大株主および持株比率	パナソニック株式会社 100%

- ⑨ 直前事業年度の経営成績および財政状態

総資産	24,789百万円(2013年3月31日現在)
売上高	22,452百万円(2013年3月期)

(2) PIDOSC の概要(2013 年 12 月 31 日現在)

① 名称	パナソニック デバイスオプティカルセミコンダクター株式会社
② 所在地	鹿児島県日置市伊集院町徳重 1786-6
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 足立 秀人
④ 事業内容	LED 半導体の製造・販売
⑤ 資本金	500 百万円
⑥ 設立年月日	1973 年 12 月 1 日
⑦ 決算期末	3 月 31 日
⑧ 大株主および持株比率	パナソニック株式会社 100%

⑨ 直前事業年度の経営成績および財政状態

総資産	7,251 百万円 (2013 年 3 月 31 日現在)
売上高	6,626 百万円 (2013 年 3 月期)

Ⅲ. 海外工場に係る子会社株式譲渡の要旨

1. 異動する子会社の概要

(1) PAISSCSG(2014 年 4 月～5 月設立予定)

① 名称(仮称)	(和文名): パナソニック オートモティブアンドインダストリアル システムズセミコンダクター シンガポール株式会社 (英文名): PANASONIC AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SYSTEMS SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.
② 所在地	シンガポール
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 梶原 大平
④ 事業内容	半導体の組立製造
⑤ 資本金	46 百万米ドル
⑥ 設立年月	2014 年 4 月～5 月(予定)
⑦ 大株主および持株比率	パナソニック アジアパシフィック株式会社 100%

⑧ 直前事業年度の経営成績および財政状態 ※

総資産	269 百万米ドル(2013 年 3 月 31 日現在) ※
売上高	703 百万米ドル(2013 年 3 月期) ※

※今後設立予定の新会社であり、経営成績および財政状態の実績値がないことから、事業譲渡元のパナソニック アジアパシフィック株式会社のシンガポール拠点における半導体組立事業の総資産および売上高の実績値を記載しております。なお、当該数値は、一部 PAISSCSG に譲渡されない事業の数値を含んでおります。

(2) PIDID

① 名称	(和文名): パナソニック デバイス インドネシア株式会社 (英文名): PT. PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES INDONESIA
② 所在地	インドネシア 西ジャワ州
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 三上 雅彦
④ 事業内容	半導体の組立製造
⑤ 資本金	60 百万米ドル(2013 年 12 月 31 日現在)
⑥ 設立年月	1996 年 3 月
⑦ 大株主および持株比率 (2013 年 12 月 31 日現在)	パナソニック アジアパシフィック株式会社 99.98% パナソニック ホールディング オランダ有限会社 0.02%

⑧ 直前事業年度の経営成績および財政状態

総資産	89 百万米ドル(2013 年 3 月 31 日現在)
売上高	92 百万米ドル(2013 年 3 月期)

(3) PIDSCMY

① 名称	(和文名): パナソニック デバイスディスクリート セミコンダクター マレーシア株式会社 (英文名): PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SEMICONDUCTOR (M) SDN. BHD.
② 所在地	マレーシア マラッカ州
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 山口 旭
④ 事業内容	ディスクリート半導体の組立製造
⑤ 資本金	36 百万マレーシアリングgit (2013 年 12 月 31 日現在)
⑥ 設立年月	1990 年 10 月
⑦ 大株主および持株比率 (2013 年 12 月 31 日現在)	パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター株式会社 100%

⑧ 直前事業年度の経営成績および財政状態

総資産	143 百万マレーシアリングgit (2013 年 3 月 31 日現在)
売上高	219 百万マレーシアリングgit (2013 年 3 月期)

2. 株式譲渡先(UMS 社)の概要

① 名称	UTAC Manufacturing Services Ltd.	
② 所在地	香港	
③ 事業内容	会社の株式の所有および事業活動の管理	
④ 設立年月日	2014 年 1 月 28 日	
⑤ 大株主および持株比率 (2014 年 2 月 4 日現在)	UTAC 社	100%
⑥ 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

3. UTAC 社の概要

① 名称	UTAC Holdings Ltd.		
② 所在地	シンガポール		
③ 代表者の役職・氏名	グループ・プレジデントおよび CEO ジョン・ネルソン		
④ 事業内容	半導体組立専業		
⑤ 資本金	698 百万米ドル(2012 年 12 月 31 日現在)		
⑥ 純資産	449 百万米ドル(2012 年 12 月 31 日現在)		
⑦ 総資産	1,794 百万米ドル(2012 年 12 月 31 日現在)		
⑧ 大株主および持株比率 (2013 年 12 月 31 日現在)	TPG	50%	
	AFFINITY EQUITY	50%	
⑨ 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

4. 株式譲渡の日程

(1) 取締役会決議日	2014 年 2 月 4 日
(2) 契約締結日	2014 年 2 月 4 日
(3) 株式譲渡実行日	2014 年 6 月 1 日(予定)

IV. 今後の見通し

本吸収分割および本吸収合併ならびに本株式譲渡による当社の 2014 年 3 月期連結業績予想への重要な影響はない見込みです。

以上

本プレスリリースには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本プレスリリースにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受ける恐れがあります。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループは、本プレスリリースの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれましては、金融商品取引法に基づく今後の提出書類およびその他の当社の行う開示をご参照下さい。

なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照ください。

- 米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向
- 多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動
- 為替相場の変動（特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている地域の通貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨）
- 資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性
- 急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入するパナソニックグループの能力
- 他企業との提携またはM&A（パナソニック電工および三洋電機の完全子会社化後の事業再編を含む）で期待どおりの成果を上げられない可能性
- パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向
- 多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力
- 製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性
- 第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約
- 諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない）
- パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延税金資産等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化
- 地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行、サプライチェーンの寸断、その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素